

超配（维持）

半导体行业双周报（2024/04/01-2024/04/14）

存储大厂先后酝酿涨价

2024年4月14日

刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

陈伟光

SAC 执业证书编号：

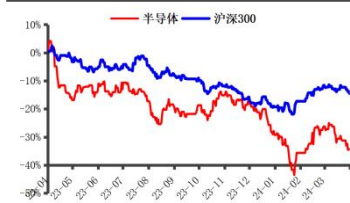
S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

投资要点：

- **半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至2024年4月12日，申万半导体板块近两周（2024/4/1-2024/4/12）下跌5.26%，跑输沪深300指数3.52个百分点；4月以来累计下跌5.26%，跑输沪深300指数3.52个百分点；2024年以来累计下跌17.76%，跑输沪深300指数19.07个百分点。
- **半导体行业指数子板块近两周涨跌幅：**截至2024年4月12日，申万半导体板块各细分指数近两周全面下跌，跌幅从低到高依次为：SW半导体材料（-2.62%）>SW分立器件（-4.69%）>SW数字芯片设计（-5.04%）>SW半导体设备（-6.94%）>SW集成电路封测（-7.20%）>SW模拟芯片设计（-7.64%）。
- **近两周部分新闻和公司动态：**（1）三大内存原厂暂停报价，或成震后涨价讯号；（2）三星和SK海力士正在提高DRAM产量，将恢复至削减前水平；（3）IDC：全球PC出货量一季度恢复增长，已达到疫情前水平；（4）固态硬盘Q1大宗交易价格涨10%，大型存储器厂商仍计划继续涨价；（5）Counterpoint：2023年第四季度全球晶圆代工行业收入环比增长约10%；（6）消息称美光拟调升Q2产品报价，涨幅超两成；（7）西部数据称HDD和SSD出现供应短缺，NAND闪存和硬盘产品正在调整价格；（8）北方华创：一季度净利润预增75%-102%；（9）容大感光：2023年归母净利润同比增62.25% 拟10转2派0.75元；（10）士兰微：2023年净利润亏损3578.58万元；（11）德明利：2024年第一季度净利润预盈1.86亿元-2.26亿元 同比扭亏；（12）南大光电：2023年归母净利润同比增13.26% 目前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售；（13）海光信息：2023年净利润同比增57.17% 拟10派1.1元；（14）澜起科技：预计一季度净利润同比增长9.65倍-11.17倍
- **周报观点：维持对半导体行业超配评级。**进入4月份，半导体板块陆续披露2023年年报、2024年一季报。从已披露企业的业绩情况看，存储和半导体设备24Q1业绩表现较好，如北方华创、德明利、澜起科技等企业Q1利润超市场预期，表明行业景气高企，板块复苏态势强劲。作为现代信息技术的基础，半导体对于新质生产力的发展具有重要意义，随着2023年年报、2024年一季报逐渐披露，预计业绩表现较好个股有望取得较好相对收益，建议重点关注存储、封测和半导体设备的投资机遇。
- **风险提示：**终端复苏不及预期，国产替代不及预期、行业竞争加剧等。

目录

1. 半导体行业行情回顾	3
2. 半导体产业新闻	4
3. 公司公告与动态	6
4. 半导体产业数据更新	8
4.1 智能手机出货数据	8
4.2 新能源汽车销售数据	8
4.3 全球、国内半导体月度销售数据	9
4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据	9
5. 投资建议	10
6. 风险提示	12

插图目录

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2024 年 4 月 12 日）	3
图 2：全球智能手机季度出货量（2016/03-2023/12）	8
图 3：国内智能手机月度出货情况（2021/01-2024/02）	8
图 4：新能源汽车销量及同比增长率（2022/01-2024/03）	8
图 5：国内新能源汽车销量及渗透率（2022/01-2024/03）	8
图 6：全球半导体月度销售情况	9
图 7：中国半导体月度销售情况	9
图 8：全球半导体设备销售额（季度）	9
图 9：中国大陆半导体设备销售额（季度）	9

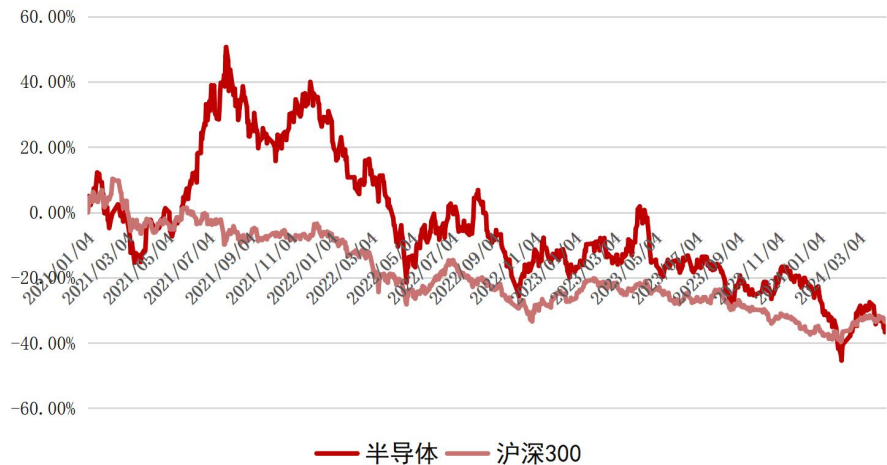
表格目录

表 1：申万半导体行业各子板块涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 4 月 12 日）	3
表 2：申万电子所有三级子行业涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 4 月 12 日）	3
表 3：建议关注标的介绍（2024/4/14）	10

1. 半导体行业行情回顾

半导体行业指数近两周涨跌幅：截至 2024 年 4 月 12 日，申万半导体板块近两周（2024/4/1-2024/4/12）下跌 5.26%，跑输沪深 300 指数 3.52 个百分点；4 月以来累计下跌 5.26%，跑输沪深 300 指数 3.52 个百分点；2024 年以来累计下跌 17.76%，跑输沪深 300 指数 19.07 个百分点。

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2024 年 4 月 12 日）



资料来源：iFind，东莞证券研究所

截至 2024 年 4 月 12 日，申万半导体板块各细分指数近两周全面下跌，跌幅从低到高依次为：SW 半导体材料（-2.62%）>SW 分立器件（-4.69%）>SW 数字芯片设计（-5.04%）>SW 半导体设备（-6.94%）>SW 集成电路封测（-7.20%）>SW 模拟芯片设计（-7.64%）。

表 1：申万半导体行业各子板块涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 4 月 12 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850812.SL	分立器件	-4.69	-4.69	-19.71
2	850813.SL	半导体材料	-2.62	-2.62	-21.64
3	850814.SL	数字芯片设计	-5.04	-5.04	-15.98
4	850815.SL	模拟芯片设计	-7.64	-7.64	-31.92
5	850817.SL	集成电路封测	-7.20	-7.20	-16.45
6	850818.SL	半导体设备	-6.94	-6.94	-7.30

资料来源：iFind、东莞证券研究所

表 2：申万电子所有三级子行业涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 4 月 12 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850813.SL	半导体材料	-2.62	-2.62	-21.64
2	850818.SL	半导体设备	-6.94	-6.94	-7.30
3	850814.SL	数字芯片设计	-5.04	-5.04	-15.98

4	850815.SL	模拟芯片设计	-7.64	-7.64	-31.92
5	850817.SL	集成电路封测	-7.20	-7.20	-16.45
6	850812.SL	分立器件	-4.69	-4.69	-19.71
7	850853.SL	品牌消费电子	-3.31	-3.31	-7.57
8	850854.SL	消费电子零部件及组装	-6.62	-6.62	-14.42
9	850861.SL	电子化学品III	-2.93	-2.93	-19.48
10	850831.SL	面板	1.48	1.48	-3.70
11	850832.SL	LED	-5.02	-5.02	-20.60
12	850833.SL	光学元件	-7.92	-7.92	-14.87
13	850822.SL	印制电路板	-6.32	-6.32	-8.07
14	850823.SL	被动元件	-3.63	-3.63	-12.48
15	850841.SL	其他电子III	-7.25	-7.25	-15.48

资料来源：iFind、东莞证券研究所

2. 半导体产业新闻

1. 【面板厂友达、群创工厂：地震对整体运营及出货无重大影响】

《科创板日报》8日讯，友达、群创工厂日前受到台湾地区地震波及，两家公司均表示，对整体运营及出货无重大影响。友达今日公告指出，友达龙潭厂区部分产能受影响，除进行系统检查外，已协调客户及调配其他厂区产能，以维持正常出货进度为目标。财物损失尚在估算中，因有相关保险，预估损失对公司营运无重大影响。综合以上，对友达整体运作及出货无重大影响。群创今日亦重申，群创第一时间已照标准程序，厂区部分机台启动预防性停机，并进行系统检查后于4月3日当日复工，对厂区运作影响有限，并对群创整体运作及出货无重大影响。

2. 【三大内存原厂暂停报价 或成震后涨价讯号】

《科创板日报》8日讯，存储供应链指出，继中国台湾地震后，三家DRAM大厂先后宣布暂停报价。除了DRAM主要产能落脚于台湾的美光之外，SK海力士、三星电子等均跟进暂停报价，以观望后续产能供给影响，连带存储器模组业者也随后停止报价。业界分析，基于近来存储器原厂持续拉抬价格的态度，如今三家原厂停止报价将可能成为涨价讯号，预料影响性将在近日内显现，并牵动第二季度合约价走势。

3. 【三星和SK海力士正在提高DRAM产量 将恢复至削减前水平】

《科创板日报》7日讯，随着全球需求复苏，韩国内存芯片制造商三星电子和SK海力士今年第二季度加大DRAM晶圆投入，有效结束减产。Omdia表示，三星电子已将今年第二季度的平均每月DRAM晶圆投入量调升至60万片，环比增长13%；预计下半年将DRAM晶圆投入量增加至66万片，DRAM产量恢复到削减前的水平。SK海力士将把每月平均DRAM晶圆投入量从第一季度的39万片增加到第二季度的41万片；下半年预计该公司的DRAM晶圆投入量将增加至45万片。

4. 【IDC：全球PC出货量一季度恢复增长 已达到疫情前水平】

财联社 4 月 9 日电，国际数据公司 IDC 的初步追踪数据显示，在经历两年下滑后，全球传统 PC 市场在 2024 年第一季度恢复增长，出货量为 5980 万部，同比增长 1.5%，全球 PC 出货量恢复到了疫情前的水平。一季度全球出货量前五的公司分别为联想、惠普、戴尔、苹果和 Acer，市场份额分别为 23%、20.1%、15.5%、8.1%和 6.2%。

5. 【固态硬盘 Q1 大宗交易价格涨 10% 大型存储器厂商仍计划继续涨价】

《科创板日报》9 日讯，嵌入 PC 的存储设备价格上涨趋势越来越强劲。固态硬盘(SSD) 1~3 月大宗交易价格比上季度高出 1 成，连续两个季度上涨。缩减供应的存储器厂商为了改善盈利而提出涨价，需求方接受了这一要求。还出现了因看涨价格而提前采购 SSD 的动向。大型存储器厂商表明今后仍计划涨价。一家电子商社高管指出，“与降价前的 2021 年夏季左右相比，价格水平仍相当便宜。存储器厂商还需要持续改善盈利”。买家为了不影响将来采购，基本都接受涨价。一家 PC 厂商的采购负责人表示，“各存储器厂商都处于亏损状态，只能接受涨价”。根据卖方的涨价要求，已确定连续 2 个季度涨价。

6. 【Counterpoint: 2023 年第四季度全球晶圆代工行业收入环比增长约 10%】

财联社 4 月 9 日电，根据 Counterpoint Research 的半导体代工服务报告，2023 年第四季度全球晶圆代工行业收入环比增长约 10%，但同比下降 3.5%。尽管宏观经济的不确定性仍然存在，但随着智能手机和平板电脑等终端市场的供应链库存补货需求驱动，该行业自 2023 年下半年开始逐步回暖。尤其是在安卓智能手机供应链中，来自 PC 和智能手机应用领域的紧急订单有所增加。

7. 【消息称美光拟调升 Q2 产品报价 涨幅超两成】

《科创板日报》9 日讯，据相关市场人士透露，存储芯片龙头美光已向多数客户提出调升 Q2 产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。

8. 【丘钛科技：3 月摄像头模组销售数量 3792.6 万件 同比持平】

财联社 4 月 9 日电，丘钛科技港交所公告，3 月摄像头模组销售数量 3792.6 万件，环比增长 32.2%，同比持平。

9. 【GPU 供货周期已大幅缩短至 8-12 周】

《科创板日报》10 日讯，戴尔台湾地区总经理廖仁祥指出，GPU 的供应紧张已经开始缓解，2023 年底供货期曾经长达 40-52 周，如今已降至 8-12 周甚至更短。

10. 【ODM 厂商 Q1 笔电、AI 服务器出货动能优于预期 下半年有望更强劲】

《科创板日报》10 日讯，以往 ODM 厂商受到消费电子市场动能影响较大，近年 AI 服务器动能强劲，各家的营运走势也与往年不同。广达笔电出货优于预期，纬创、英业达服务器动能强劲，第一季度淡季不淡。主要原因由于 H100 供货由紧转松，带动原先积压在手的 AI 服务器开始出货；另外，美系客户调节笔电订单比重，带动部分 ODM 笔电的出货动能激增。且展望第二季度，ODM 厂也普遍认为成长可期，下半年动能有望更强。（台湾电子时报）

11. 财联社 4 月 9 日电，舜宇光学 3 月手机镜头出货量 1.13 亿，同比增长 33.7%。3 月手机摄像模组出货量 4,190 万，同比增长 15.1%。

12. 【西部数据称 HDD 和 SSD 出现供应短缺 NAND 闪存和硬盘产品正在调整价格】

《科创板日报》9 日讯，TrendForce 消息称，存储芯片大厂西部数据 4 月 8 日首次确认 HDD 和 SSD 均出现供应短缺。公司发出正式客户信函，通知 NAND 闪存和硬盘产品正在进行价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。

13. 【美光：中国台湾地区地震对单季 DRAM 供应影响最多介于 4%-6%之间】

《科创板日报》12 日讯，存储芯片大厂美光表示，中国台湾地区地震对单季 DRAM 供应影响最多介于 4%~6%之间（mid-single digit percentage）。这次地震并未对厂房、基础设施或设备造成永久性伤害，不会对 DRAM 供应造成长期影响。震后的 DRAM 生产尚未完全恢复，但在团队的努力下，厂房复原进度良好。

3. 公司公告与动态

1. 【北方华创：一季度净利润预增 75%-102%】

财联社 4 月 12 日电，北方华创公告，预计 2024 年第一季度净利润 10.4 亿元-12 亿元，同比增长 75.77%-102.81%。报告期内，公司持续聚焦主营业务，精研客户需求，深化技术研发，不断提升核心竞争力。公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升，收入同比稳健增长。随着公司经营规模的持续扩大，规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降，使得归属于上市公司股东的净利润保持同比增长。

2. 【容大感光：2023 年归母净利同比增 62.25% 拟 10 转 2 派 0.75 元】

财联社 4 月 8 日电，容大感光发布年度报告，公司实现营业收入 7.99 亿元，同比增长 8.70%；归属于上市公司股东的净利润为 8548.57 万元，同比增长 62.25%；基本每股收益为 0.36 元。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

3. 【澜起科技：预计一季度净利润同比增长 9.65 倍-11.17 倍】

《科创板日报》10 日讯，澜起科技公告，预计一季度净利润 2.10 亿元-2.40 亿元，较上年同期增长 9.65 倍-11.17 倍；扣非净利润 2.10 亿元-2.35 亿元，较上年同期增长 708.62 倍-793.10 倍。互连类芯片产品线销售收入约为 6.95 亿元，创该产品线第一季度销售收入历史新高（前次记录是 2022 年第一季度的 5.75 亿元）；自今年年初以来，内存接口芯片需求实现恢复性增长，公司部分新产品（如 PCIe Retimer、MRCD/MDB 芯片）开始规模出货，推动公司 2024 年第一季度收入及净利润较上年同期大幅增长。

4. 【士兰微：2023 年净利润亏损 3578.58 万元】

财联社 4 月 8 日电，士兰微披露年报，公司 2023 年实现营业收入为 93.4 亿元，同比增长 12.77%；归属于母公司股东的净利润亏损 3578.58 万元，上年同期盈利 10.52 亿元。公司实现归属于母公司所有者的扣非后净利润 5890 万元，比 2022 年减少 90.67%。2023 年，公司归属于母公司股东的净利润出现亏损的主要原因，系公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌，导致其公允价值变动产生税后净收益-4.52 亿元。

5. 【德明利：2024 年第一季度净利润预盈 1.86 亿元-2.26 亿元 同比扭亏】

财联社 4 月 9 日电，德明利发布 2024 年第一季度业绩预告，第一季度归母净利润预盈 1.86 亿元-2.26 亿元，上年同期亏损 4378.44 万元，同比扭亏。报告期内，公司持续聚焦存储主业，不断完善产品矩阵，积极拓展下游终端客户和销售渠道，前期大量产品验证及导入成果显著。以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好，存储行业价格自 2023 年三季度起至今一直处于上升通道，公司销售收入规模、毛利率增长延续良好态势，净利润水平较去年同期大幅提升。

6. 【南大光电：2023 年归母净利同比增 13.26% 目前研发的三款 ArF 光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售】

财联社 4 月 9 日电，南大光电发布年度报告，2023 年实现营业收入 17.03 亿元，同比增长 7.72%；归母净利润为 2.11 亿元，同比增长 13.26%；基本每股收益 0.39 元。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。公司目前研发的三款 ArF 光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售，多款产品正在主要客户处认证。

7. 【南大光电：通过验证的第三款 ArF 光刻胶已实现销售】

财联社 4 月 11 日电，南大光电于业绩说明会上表示，公司通过验证的第三款 ArF 光刻胶产品是浸没式光刻胶，已实现销售。

8. 【海光信息：2023 年净利润同比增 57.17% 拟 10 派 1.1 元】

《科创板日报》11 日讯，海光信息披露年报，公司 2023 年实现营业收入为 60.12 亿元，同比增长 17.3%；归母净利润 12.63 亿元，同比增长 57.17%；基本每股收益 0.54 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。公司整体经营情况持续向好，高端处理器产品的产业生态持续扩展，涉及的行业应用以及新兴人工智能大模型产业逐步增加。

9. 【晶晨股份：预计一季度净利润同比增长 310.68%】

财联社 4 月 11 日电，晶晨股份公告，公司预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 1.25 亿元左右，同比增长 310.68%左右。2024 年第一季度，公司营收和净利润保持了较高速度的增长（营收同比增长 33.12%左右，归属于母公司所有者的净利润同比增长 310.68%左右）。公司多元化产品策略成果显著，多产品系列齐头并进，市场份额稳步提升。其中 T 系列芯片不断完成主流生态系统认证，2024

年第一季度销售收入同比增长超过 100%。

10. 【瑞芯微：预计一季度净利润 6000 万元到 7000 万元 同比扭亏】

财联社 4 月 11 日电，瑞芯微公告，预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 6000 万元到 7000 万元，上年同期亏损 1838 万元。报告期内，公司在汽车电子，工业应用，机器视觉等领域完成同比大幅提升，在毛利率保持稳定的情况下，总体实现营收增长约 64%到 67%，实现净利润 6000 万元到 7000 万元。公司同日发布业绩快报，2023 年营业收入为 21.35 亿元，同比增长 5.17%；归母净利润 1.35 亿元，同比下滑 54.65%；基本每股收益 0.32 元。

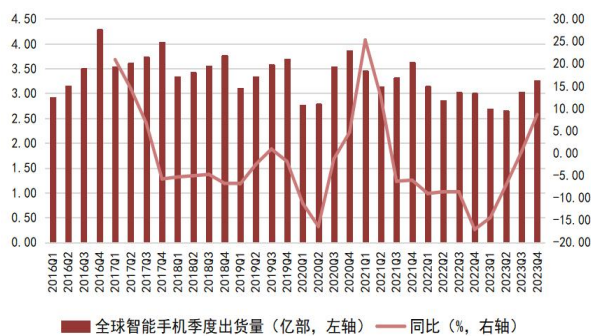
4. 半导体产业数据更新

4.1 智能手机出货数据

全球智能手机出货数据：根据 IDC 数据，2023 年第四季度全球智能手机出货量为 3.26 亿台，同比增长 8.59%，环比增长 7.69%；2023 年全年智能手机出货量为 11.63 亿台，相比 2022 年下滑 3.29%；

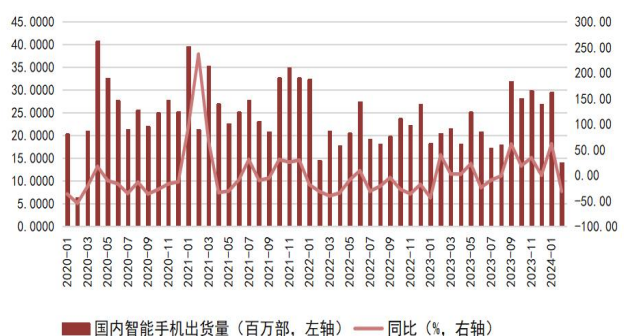
国内智能手机出货数据：根据工信部数据，2024 年 2 月国内智能手机出货量为 1,404.20 万台，同比下降 31.3%，环比下降 52.42%。2023 年全年国内智能手机出货量合计为 2.76 亿台，同比增长 4.87%。

图 2：全球智能手机季度出货量（2016/03-2023/12）



资料来源：IDC，东莞证券研究所

图 3：国内智能手机月度出货情况（2021/01-2024/02）

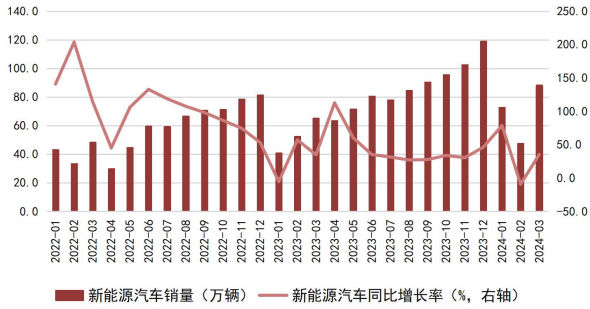


资料来源：工信部，东莞证券研究所

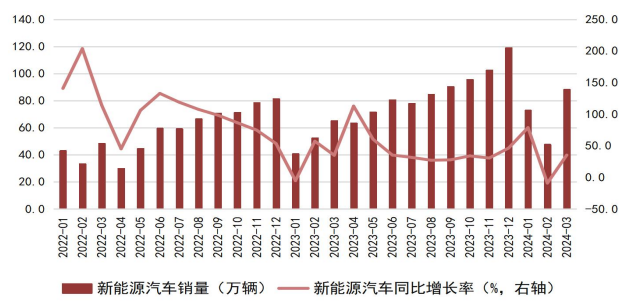
4.2 新能源汽车销售数据

新能源汽车销售数据：据工信部，2024 年 3 月，国内新能源汽车总销量为 88.3 万辆，同比增长 35.2%，环比增长 32.78%，2024 年 3 月国内汽车总销量为 269.4 万台，其中新能源汽车销量占比为 32.78%。

图 4：新能源汽车销量及同比增长率（2022/01-2024/03）图 5：国内新能源汽车销量及渗透率（2022/01-2024/03）



资料来源：中汽协，东莞证券研究所

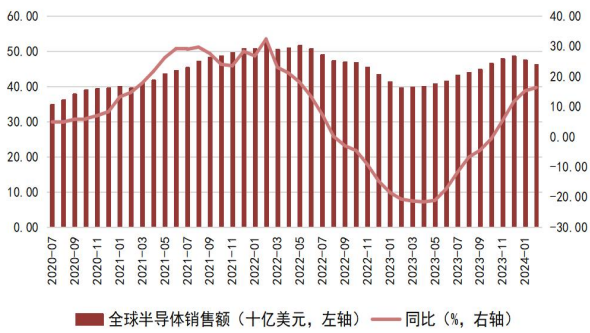


资料来源：中汽协，东莞证券研究所

4.3 全球、国内半导体月度销售数据

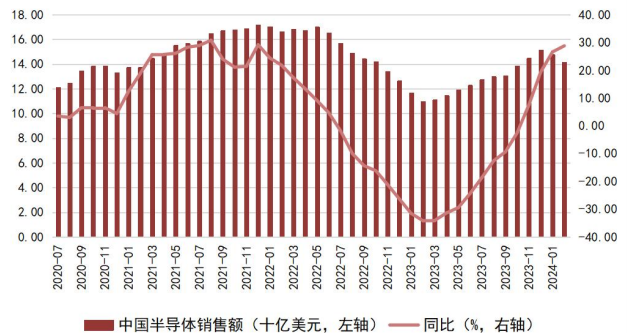
全球、中国半导体销售数据：根据美国半导体行业协会数据，2024年2月全球半导体销售额为461.7亿美元，同比增长16.30%，环比下降3.07%；国内半导体2023年2月销售额为141.3亿美元，同比增长28.80%，环比下降4.27%。

图6：全球半导体月度销售情况



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

图7：中国半导体月度销售情况



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据

全国、中国大陆半导体设备销售额：根据SEAJ数据，2023年第四季度全球半导体设备销售额为255.9亿美元，同比增长0.94%，其中中国大陆半导体设备销售额为121.3亿美元，同比增长90.81%。

图8：全球半导体设备销售额（季度）



资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

图9：中国大陆半导体设备销售额（季度）



资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

5. 投资建议

维持对半导体行业超配评级。进入4月份，半导体板块陆续披露2023年年报、2024年一季报。从已披露企业的业绩情况看，存储和半导体设备24Q1业绩表现较好，如北方华创、德明利、澜起科技等企业Q1利润超市场预期，表明行业景气高企，板块复苏态势强劲。作为现代信息技术的基础，半导体对于新质生产力的发展具有重要意义，随着2023年年报、2024年一季报逐渐披露，预计业绩表现较好个股有望取得较好相对收益，建议重点关注存储、封测和半导体设备的投资机遇。

存储：行业从2023年下半年开始持续复苏，主要NAND、DRAM型号价格持续上涨，澜起科技、德明利等企业24Q1业绩实现同比大幅增长。海外方面，美光发布2024财年第二财季财报，业绩超出市场预期。作为占比最高的半导体品类之一，存储行业的波动情况大于其他细分半导体品类，因此在板块复苏时有望获得向上的业绩弹性。此外，据美光科技业绩说明会，人工智能服务器需求火爆，推动了HBM、DDR5和SSD的快速增长，并加剧了DRAM、NAND供应的紧张程度，这将对所有内存和存储终端市场的定价产生积极影响，预计DRAM和NAND的定价水平有望在24Q2进一步提高；

封测：行业复苏渐行渐近，板块Q4稼动率改善。根据长电科技、华天科技和通富微电业绩与估值。三家企业中部分2023年归母净利润同比下滑，但环比改善。主要原因为下游半导体行业正逐步复苏，推动封测板块稼动率提升。如通富微电财务部门初步统计，公司2023年营收呈现逐季走高趋势，且2023年下半年业绩较2023年上半年业绩大幅改善，行业景气度有望在24Q1进一步回升；

设备：半导体国产替代的关键环节，当前我国设备整体国产化率较低，但近年来已取得较大进步。近日，荷兰首相访华，与中国商讨光刻机巨头ASML是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题；而根据中国海关总署的数据，2024年1-2月，中国大陆从荷兰进口光刻机金额实现同比高增，总金额为10.57亿美元，同比增长256.1%。随着2024年1-2月荷兰光刻机进口额同比增长，有望助力国内晶圆厂持续扩产，带动半导体设备及零部件需求增长。

建议关注标的：

- ▶ **半导体设备与材料：**北方华创（002371）、中微公司（688012）、鼎龙股份（300054）、江丰电子（300666）；
- ▶ **存储芯片：**兆易创新（603986）、澜起科技（688008）；
- ▶ **先进封装：**长电科技（600584）、通富微电（002156）；
- ▶ **射频&CIS：**卓胜微（300782）、韦尔股份（603501）、思特威（688213）；
- ▶ **算力芯片：**海光信息（688041）

表3：建议关注标的介绍（2024/4/14）

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
002371	北方华创	公司预计 2024 年第一季度净利润 10.4 亿元-12 亿元，同比增长 75.77%-102.81%。报告期内，公司持续聚焦主营业务，精研客户需求，深化技术研发，不断提升核心竞争力。公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升，收入同比稳健增长。随着公司营收规模的持续扩大，规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降，使得归属于上市公司股东的净利润保持同比增长。2023 年全年，公司主营业务发展态势良好，市场认可度不断提高，应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升；公司全年新签订单超过 300 亿元，其中集成电路领域占比超 70%，为中长期业绩增长贡献确定性。
688012	中微公司	公司于 3 月 18 日披露 2023 年年报。公司 2023 年实现营收 62.64 亿元，同比增长 32.15%，实现归母净利润 17.86 亿元，同比增长 52.67%。其中，公司 2023 年刻蚀设备实现收入 47.03 亿元，同比增长 49.43%，市占率持续提升并不断收到头部客户的批量订单；公司 2023 年 MOCVD 设备实现收入 4.62 亿元，在 Mini Led 等氮化镓设备领域市场占有率保持领先。报告期内，公司重视核心技术创新，全年实现研发投入 12.62 亿元，同比增长 35.89%。
300054	鼎龙股份	据公司 2023 年全年业绩预告，受研发费用等支出增加和行业景气度下滑的叠加影响，公司业绩同比下滑。但从细分产品来看，2023 年第四季度公司半导体新材料业务营收实现了同比及环比增长，产品品类不断完善。随着后续半导体新材料业务持续放量，以及行业景气度逐步回暖，公司业绩有望迎来触底反弹。
300666	江丰电子	公司于 2 月 28 日发布 2023 年业绩快报，预计 2023 年实现营收 25.76 亿元，同比增长 10.80%，预计实现归母净利润 2.32 亿元，同比下降 12.08%。报告期内，受到全球经济环境、半导体行业周期等影响，但公司始终积极扩大全球市场份额，营收规模实现增长；同时，公司持续加大研发投入，积极推进超高纯金属溅射靶材扩产项目，强化半导体精密零部件领域的战略布局，市场认可度不断提高。后续随着外围环境及行业周期好转，将有望加强公司的核心竞争力和盈利能力。目前，上述项目的扩产和推进，导致相应成本费用有所增加，同时受到产品销售结构变化、精密零部件和第三代半导体材料新品开发试制增加等多种因素影响，公司经营业绩较上年同期有所下降。
603986	兆易创新	公司预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 15,500 万元左右，与上年同期相比减少 189,757 万元左右，同比降幅 92.45%左右；预计 2023 年度实现营业收入 57.66 亿元左右，与上年同期相比减少 23.64 亿元左右，同比下降 29.08%左右；对应 23Q4 营收为 13.72 亿元，同比增长 0.78%，环比下降 4.00%，对应 Q4 归母净利润为-2.79 亿元，环比由盈转亏。受全球经济环境、行业周期等影响，2023 年公司所处半导体行业仍面临需求复苏缓慢的严峻考验，同时行业竞争激烈，导致公司产品销售价格和毛利率下滑明显。公司努力开拓市场，产品出货量同比增加，但由于产品价格大幅下降，2023 年度公司营业收入、毛利出现下滑；此外本年度公司计提资产减值损失，全年商誉、存货等资产减值损失预计 6.12 亿元左右。其中商誉减值损失预计 3.8 亿元左右，存货减值损失预计 2.32 亿元左右，对业绩造成不利影响。
688008	澜起科技	澜起科技公告，预计一季度净利润 2.10 亿元-2.40 亿元，较上年同期增长 9.65 倍-11.17 倍；扣非净利润 2.10 亿元-2.35 亿元，较上年同期增长 708.62 倍-793.10 倍。互连类芯片产品线销售收入约为 6.95 亿元，创该产品线第一季度销售收入历史新高（前次记录是 2022 年第一季度的 5.75 亿元）；自今年年初以来，内存接口芯片需求实现恢复性增长，公司部分新产品（如 PCIeRetimer、MRCD/MDB 芯片）开始规模出货，推动公司 2024 年第一季度收入及净利润较上年同期大幅增长。
300782	卓胜微	公司预计 2023 年度实现营业收入 43.78 亿元，较去年同期增长约 19.06%，预计 2023 年实现归母净利润 11.65 亿元，同比增长 8.92%。2023 年度，虽然上半年全球经济增速放缓使得公司主要下游应用智能手机市场需求疲软，但是下半年受益于节假日消费刺激传导和客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。报告期内，公司聚焦自建滤波器产线，在推动有序规模量产的基础上，加快产品的迭代升级速度，响应客户多样化需求，不断深化射频滤波器模组产品的市场覆盖，下半年业绩实现明显改

表 3：建议关注标的介绍（2024/4/14）

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		善。
603501	韦尔股份	1. 全球 CIS 龙头企业，在手机、汽车均有布局，手机端 CIS 向高端化迈进，50MP 已用于国内部分品牌旗舰手机； 2. 023 年前三季度实现营收 150.81 亿元，同比下降 1.96%，实现归母净利润 3.68 亿元，同比下降 82.86%，对应 23Q3 营收为 62.23 亿元，同比增长 44.35%，环比增长 37.58%，对应 23Q3 净利润为 2.15 亿元，同比增长 279.61%。报告期内公司大客户产品顺利出货，叠加消费电子产业触底，公司去库存顺利推进，因此业绩实现触底反弹。
688213	思特威	公司公布 2023 年业绩快报。预计 2023 年实现营收 25.57 亿元，同比增长 15.08%，预计 2023 年实现归母净利润 1,371 万元，同比实现扭亏为盈。告期内，公司在消费电子领域与现有客户在各阶产品领域的合作不断深入，市场占有率持续提升；高阶 5000 万像素产品量产出货顺利，该类主要产品应用于高端旗舰手机的主摄、广角、长焦等摄像头，且单价较高，为公司的消费电子领域营收开辟出第二条增长曲线。在应用于机器视觉的智慧安防领域，公司发布多颗专业级 CIS 产品，产品矩阵的不断扩展支撑公司机器视觉业务呈现出强劲增长态势。因此本报告期内，公司的营业收入较上年有所增加。
600584	长电科技	公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 13.22 亿元到 16.16 亿元，同比减少 49.99% 到 59.08%，若取预告区间中值，对于 Q4 归母净利润同比下滑 36.38%，环比增长 3.61%。报告期内，全球终端市场需求疲软，半导体行业处于下行周期，导致客户需求下降，产能利用率降低。同时，受价格承压影响，整体利润下降。公司严格控制各项营运费用，抵消部分不利影响。从公司业绩预告情况来看，下半年相比上半年，业绩同比下降幅度有所减缓，下半年部分客户需求有所回升，四季度订单总额恢复到上年同期水平。
002156	通富微电	公司预计 2023 年实现归母净利润 1.30 亿元至 1.80 亿元，同比下降 64.14% 至 74.10%，若取预告区间中值，对应 23Q4 实现归母净利润 2.19 亿元，同比增长 766.10%，环比增长 76.30%。2023 年，公司立足市场最新技术前沿，努力克服传统业务不振及产品价格下降带来的不利影响，积极推动 Chiplet 市场化应用，承接算力芯片订单，实现规模性量产。据公司财务部门初步统计，公司 2023 年营收呈现逐季走高趋势，且 2023 年下半年业绩较 2023 年上半年业绩大幅改善，扭亏为盈。公司紧紧围绕先进封装，在高性能计算、存储等领域不断加大研发投入和产能建设，未来业绩有望迎来新一轮增长。
688041	海光信息	据公司年报，公司 2023 年实现营业收入为 60.12 亿元，同比增长 17.3%；归母净利润 12.63 亿元，同比增长 57.17%；基本每股收益 0.54 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。公司整体经营情况持续向好，高端处理器产品的产业生态持续扩展，涉及的行业应用以及新兴人工智能大模型产业逐步增加。报告期内，公司始终围绕通用计算市场，保持着高强度的研发投入，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争优势，在收入、毛利率方面持续提升，进一步夯实了公司的领先优势和市场竞争力，实现了业绩的持续增长。

资料来源：iFind，东莞证券研究所

6. 风险提示

（1）下游需求不及预期：半导体行业当前正处于逐步复苏期，若终端需求复苏力度不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响；

（2）国产替代不及预期：半导体设备与材料、高端被动元器件等领域的国产替代是大势所趋，若产业链公司技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；

（3）行业竞争加剧：目前在集成电路、被动元器件等领域，国内上市企业以生产中低端产品为主，高端领域国产替代空间较大。若上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来竞争加剧的风险。

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内

行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：www.dgzq.com.cn